公司代码:688403　　公司简称:汇成股份
转债代码:118049　　转债简称:汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关内容。请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年度利润分配预案为:拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至 2025 年 3 月 18 日,公司总股本 897,840,630 股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利 44,892,031.50 元(含税),占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 29.01%。

如在年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份 / 可转债转股 / 股权激励授予 / 股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化,公司将在权益分派实施前另行公告具体调整情况。

公司 2025 年度利润分派预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	汇成股份	688403	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	奚勰	王赞
联系地址	安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号	安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号
电话	0551-67139968-7099	0551-67139968-7099
传真	0551-67139968-7099	0551-67139968-7099
电子信箱	zhengquan@unionsemicon.com.cn	zhengquan@unionsemicon.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营集成电路先进封装测试服务,所封测的芯片类型目前聚焦在液晶面板核心部件之一显示驱动芯片,并持续布局存储芯片封测领域。公司直接客户主要为显示驱动芯片设计企业,客户自购晶圆委托公司为其提供凸块制造(Bumping)、晶圆测试(CP)、玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF)加工服务,加工完成后的显示驱动芯片由客户销售给下游,主要应用于 LCD、OLED 显示面板,并应用于消费电子、工业控制、车载电子等终端应用场景。

报告期内,公司主要提供显示驱动芯片全制程封装测试统包服务。在封测业务制程方面,公司主营业务收入一般按照凸块制造(Bumping)、晶圆测试(CP)、玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF)四大制程进行划分;按照所封测芯片的细分类型,主要分为 LCD 面板显示驱动芯片(DDI)、触控与显示驱动集成芯片(TDDI)、AMOLED 面板显示驱动芯片等;按照终端应用场景,主要分为智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、汽车电子、电子标签等类别。公司显示驱动芯片封装测试制程服务具体情况如下:

工艺制程	具体介绍	功能特点	应用范围或领域
Bumping	凸块制造是指通过溅镀、曝光显影、电镀和蚀刻等制程,在晶圆的焊垫上制作凸块,可达到高效的电性传输,替代了传统封装中的导线键合。公司凸块制造工艺可实现凸块宽度与间距最小至 6μm、单片 12 吋晶圆上制造约千万颗凸块	该工艺可大幅缩小芯片模组的体积,具有密度大、散热佳、高可靠性等优点	主要应用于显示驱动芯片领域,适用于覆晶封装(FC)技术
CP	晶圆测试是指用探针与晶圆上的每个晶粒接触进行电气连接以检测其电气特性,对于检测不合格的晶粒用点墨进行标识,在切割环节被淘汰,不再进行下一个制程	该工艺不仅可以鉴别出合格的芯片,直接计算出良率,还可以减少后续不必要的操作,有效降低整体封装的成本	是大多数封装工艺必经的前道工序
COG	玻璃覆晶封装是指将芯片上的金凸块与玻璃基板上的引脚进行接合并利用胶质材料进行密封隔绝的技术,由封装厂商负责切割成型,面板或模组厂商等负责芯片与面板的接合	是目前较为传统的屏幕封装工艺,也是最具有性价比的解决方案,但由于芯片直接放置在玻璃基板上,占用较大空间,故屏占比不高	主要应用于小尺寸面板,如手机、平板电脑、数码相机等
COF	薄膜覆晶封装是指将芯片的凸块与卷带上的内引脚接合,之后由面板或模组厂商等将外引脚与玻璃基板接合	具有高密度、高可靠性、轻薄短小、可弯曲等优点,有利于缩小屏幕边框,提高屏占比	主要应用于电视等大尺寸面板和全面屏手机等

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业,采用行业惯用的 OSAT(半导体封装测试外包)模式,在 OSAT 模式下,公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节,专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。公司根据客户需求,通过工艺设计,利用封装测试设备,自行购买封装测试原辅料,对客户提供的晶圆进行凸块制造、晶圆测试、研磨、切割、封装等一系列的定制化精密加工及成品测试服务。公司通过为客户提供服务并收取加工服务费的方式获取收入和利润。

2、采购模式

公司的采购模式为按需采购,由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单,根据需求单向供应商下达采购订单并签约。对于主要采购材料,公司一般会与供应商约定年度协议价格,未约定年度协议价格的则进行比价选定。采购材料根据合同要求付款,由采购部门根据合同约定制作付款申请单、经系统签核后,到期支付款项。采购材料到货后由相关部门进行验收,品质部门核对供应商提供的出货检测报告后进行分类抽检,检验合格后在系统中制作验收单,经系统签核后确认收货。

公司建立了供应商认证准入机制和考核机制,以保证供应质量及供应稳定性。公司仅向评估合格的供应商进行采购,评估内容包括供应商资质、材料质量、采购效益等,并且在采购的过程中持续考核其产品质量及服务等方面,对质量问题实时反馈并要求修正。

3、生产模式

公司目前采用行业普遍的"客户定制,以销定产"受托加工生产模式,即由客户提出需求并提供晶圆、卷带等制造材料,公司自行外购电镀液、金属靶材等封装测试原辅料,接着根据客户需求完成相应工艺制程,而后将成品交付给客户或指定面板厂商等第三方。

公司专注于提供高端封装和测试服务,拥有专业的工程技术和生产管理团队,并配备了专业的高精度自动化生产设备,可以为客户提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试服务。

4、销售模式

公司采用直销模式进行销售,并制定了相应的销售管理制度。

作为集成电路封装测试企业,公司需要对客户的技术需求进行工艺验证,验证通过后方能与客户开始合作。公司在获取客户具体订单后完成封装测试服务,并依据客户的具体要求将封装完成的芯片交付。公司依据与客户的具体约定进行销售结算及收款。

基于定制化的受托加工模式,公司的销售定价主要由自行采购的材料成本以及根据客户对工艺的要求协商达成的加工服务费共同构成。由于每个客户的芯片封装测试方案都具有定制化、个性化的特点,整体定价在衡量客户订单规模、公司产能综合利用情况并结合市场供需行情等因素下,与客户协商确定。后续亦会根据客户的特定工艺要求等做相应调整。

凸块制造的定价基于耗用的原材料成本及相应的加工服务费确定。晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装主要基于不同芯片的具体工艺要求,综合考虑加工设备类型、加工时长及市场供需行情的因素下,与客户协商确定。

5、研发模式

公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动,夯实已有技术基础的同时进一步提高技术壁垒,并保障研发项目成功投产转化。公司主要基于客户产品或技术方案的最新趋势,进行相应的研发投入。公司制定的研发流程主要包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段,具体情况如下:

(1)项目调研

公司的研发项目主要来源于以下渠道:一是研发中心会定期调研行业发展趋势,结合公司发展战略及现有技术基础,选择相应的新技术、新工艺的研发立项;二是业务营销部在市场开拓过程中会有意收集客户需求信息,形成对市场需求的综合判断,针对市场需求集中的新产品提出立项建议。

(2)项目立项

研发中心在项目调研或收到立项建议后,将先进行初步论证,如初步论证可行,则会同公司管理层共同讨论立项建议,根据开发产品、工艺的技术指标、技术难点、成本效益等内容进行评判,确定具体研发内容,进而对资源配置、执行周期、项目人员等进行部署,形成研发项目立项书后正式启动项目研发工作。

(3)工艺设计与开发

公司根据项目立项书及技术可行性分析的要求,开展设计开发工作。由研发中心设立专项课题小组,积极调动各种资源以配合专项课题小组的活动。工艺设计开发完成后,将召开评审会议,对项目取得的研发成果予以评定。专项课题小组根据会议评审结果,对项目设计与开发方案予以进一步修改、完善,并及时反馈给研发中心相关负责人。

(4)样品试制

专项课题小组会同生产制造部根据评审会议确定的技术参数和开发方案进行样品试制,专项课题小组辅以监督和技术指导,试制完成的样品由品质保障部进行质量及性能的检验。若该研发样品是根据客户需求开发的,则样品还需经过客户验证。

(5)研发结项

在验证合格后,研发中心将召开项目评审会,对样品的性能参数予以全面评估。评审会通过后专项课题小组提交研发结项报告,项目研发工作结束。

2.3 所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主营业务为集成电路的封装测试,根据《国民经济行业分类》(GB/4754-2017),公司属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"之"C3973 集成电路制造业";根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于"1 新一代信息技术产业"之"1.2 电子核心产业"之"1.2.4 集成电路制造业",是电子核心产业中兼具技术密集与资金密集属性的关键环节。

(2)行业发展阶段及基本特点

自上世纪 50 年代集成电路诞生以来,集成电路封装测试行业随着集成电路设计和制造技术的发展而演进,已历经了 60 余年的发展过程,大致可以划分为五个发展阶段:20 世纪 70 年代以前属于集成电路封装技术发展的第一阶段,以通孔插装型封装为主;20 世纪 80 年代以后开始进入第二阶段,以表面贴装型封装为主;20 世纪 90 年代以后,以芯片级封装(CSP)、晶圆级封装(WLP)、球栅阵列封装(BGA)为代表的面积阵列型封装技术逐渐成熟,进入封装技术发展的第三阶段;20 世纪末开始,凸块制造(Bumping)、系统级封装(SiP)等技术推动集成电路封装进入第四阶段;进入 21 世纪之后,倒装封装(FC)、晶圆级系统封装 – 硅通孔(TSV)、系统级单芯片封装(SoC)、扇出型封装(Fan-out)等形式的集成电路封装层出不穷,封装技术发展进入第五阶段。基于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》,并结合行业内按照封装工艺分类的惯例,封装分为传统封装(第一阶段和第二阶段)及先进封装(第三至第五阶段)。

先进封装是现代集成电路制造技术的关键环节,即采用先进的设计思路和先进的集成工艺对芯片进行封装级重构,并能够有效提高功能密度的封装方式。在业内,先进封装和传统封装主要以是否采用引线焊接来区分,传统封装通常采用引线键合的方式实现电气连接,先进封装通常采用凸块(Bump)等键合方式实现电气连接。从封装效果来看,传统封装更加关注物理连接层面的优化,本身对芯片的功能不会产生实质变化,主要起到保护、嵌套、连接的作用;先进封装更加关注电路系统层面的优化,除常规的保护、嵌套、连接外,还可起到缩短互联长度、提高互联性能、提升功能密度、实现系统重构等作用。

近年来,智能手机等移动终端向小型化、集成化、高性能方向更新迭代,带动单机芯片数量和芯片性能要求的提升,是全球先进封装行业发展的最重要驱动因素之一。未来,全球先进封装行业的主要增长点将由智能手机等移动终端向人工智能、数据中心、云计算、自动驾驶等高性能运算转变。在后摩尔定律时代,以凸块制造(Bumping)、重布线(RDL)、硅通孔(TSV)、混合键合(Hybrid bonding)、三维芯片集成(2.5D/3D)、扇出型封装(FOWLP)等为代表的先进封装工艺正逐步发展为推动芯片效能提升的主流发展方向,先进封装在整体封装产业当中的占比正稳步提升。

(3)主要技术门槛

集成电路高端先进封装测试属于高新技术产业,先进封装测试服务的专业性、复杂性、系统性特征,决定了企业进入该行业需突破较高的技术壁垒。芯片封装测试对设备、工艺以及生产稳定性有着严苛的要求,客户验证和导入的周期较长。

显示驱动芯片封装测试的技术壁垒主要体现在凸块制造环节工艺复杂性、全流程良率稳定性两个方面。

凸块制造环节具有溅镀、黄光(光刻)、蚀刻、电镀等多道环节,需要在单片晶圆表面制作数百万个极其微小的凸块作为芯片封装的引脚,对凸块制造的精度、可靠性、微细间距均具有较高的要求,因而目前中国大陆具备较高良率水平及稳定量产凸块制造能力的封测企业相对较少。

显示驱动芯片领域对于封装测试有着较高的良率要求。显示驱动芯片应用于各类电子产品液晶面板,单块液晶面板的价值较高,特别是应用于高清电视等终端的大尺寸面板。如果在封装测试环节不合格品流向终端客户,封测企业将面临较大金额的质量赔付,并且还存在声誉损失甚至客户流失的风险。正是因为客户以及终端对良率的高要求,倒逼显示驱动芯片封测企业需要投入大量技术资源和管理资源用于提高良率,保证生产稳定性,行业新进入者面临着较高的良率稳定性壁垒。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力的封测厂商之一,拥有 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试技术和产能。近年来,随着公司 IPO 及可转债募投项目快速实施,公司在产能规模、实际产出、市场份额等方面均实现了跨越式发展,技术水平、产品良率及客户认可度亦稳步提升,在全球显示驱动芯片封测领域已跻身第一梯队,具备领先优势。

公司在显示驱动芯片封装测试领域深耕多年,凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力,积累了丰富的客户资源。公司客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子、三星 LSI、集创北方、奕力科技、云英谷、新相微等全球知名显示驱动芯片设计企业。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

目前,全球已步入以算力为核心生产力的全面数字经济时代,数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。数字经济的快速发展不仅带动集成电路市场需求激增,更对其性能提出更高要求。

由于摩尔定律逐步逼近极限,单纯依靠制程节点推进已无法有效优化芯片性能与功耗,且面临成本、良率等多重挑战。先进封装技术凭借提升封装集成度,实现了芯片性能与功耗的实质性突破,正逐步成为封测行业发展主流。在 AI、HPC、高速通信等终端应用领域迅猛发展的驱动下,以 TSV、Fan-Out、WLCSP 为代表的先进封装技术市场需求迎来爆发性增长。与此同时,HBM、Chiplet 等前沿领域的发展,进一步推动先进封装技术迭代与产业应用向纵深演进。

此外,先进封装技术要求芯片前期设计融合晶圆制造与封装测试技术,倒逼封测企业与上下游环节建立更加紧密的跨环节沟通机制。产业链协同能力,正成为衡量封测企业核心竞争力的关键考量。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,874,601,292.34	4,591,223,702.62	6.17	3,596,296,963.42
归属于上市公司股东的净资产	3,548,994,652.26	3,201,070,920.63	10.87	3,132,030,678.41
营业收入	1,783,135,467.97	1,501,019,718.15	18.79	1,238,293,041.85
利润总额	159,014,574.99	153,350,052.42	3.69	195,582,886.58
归属于上市公司股东的净利润	154,730,588.81	159,764,193.29	-3.15	195,985,017.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,099,626.09	134,003,912.85	-7.39	168,194,709.94
经营活动产生的现金流量净额	692,458,788.26	500,863,803.23	38.25	351,459,642.36
加权平均净资产收益率(%)	4.68	5.12	下降 0.44 个百分点	6.49
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	–	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26	0.23
研发投入占营业收入的比例(%)	6.60	5.96	上升 0.64 个百分点	6.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	374,578,911.73	491,614,195.51	429,164,325.87	487,778,034.86
归属于上市公司股东的净利润	40,588,834.35	55,450,975.13	28,205,059.00	30,485,720.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,181,714.67	48,637,711.63	19,260,895.34	22,019,304.45
经营活动产生的现金流量净额	150,299,217.76	236,229,633.78	90,094,560.56	215,835,376.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,521
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,513
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)	0	174,103,622	20.04	0	无		其他
香港中央结算有限公司	39,197,823	42,000,068	4.83	0	无		境外法人
汇成投资控股有限公司	0	37,716,667	4.34	0	无		境外法人
杨会	0	23,593,934	2.72	0	无		境内自然人
杨绍校	3,908,822	22,160,424	2.55	0	无		境外自然人
ADVANCE ALLIED LIMITED	0	20,000,000	2.30	0	无		境外法人
合肥新汇成微电子股份有限公司-2025 年员工持股计划	18,990,900	18,990,900	2.19	0	无		其他
金燕	-104,976	15,504,391	1.78	0	无		境内自然人
宝信国际投资有限公司	0	12,500,000	1.44	0	无		境外法人
GREAT TITLE LIMITED	-1,100,000	11,896,933	1.37	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	①郑瑞俊、杨会为公司实际控制人,两人系夫妻关系。上述股东中,扬州新瑞连为杨会担任执行事务合伙人的企业,汇成投资为郑瑞俊控制的境外公司。上述股东中,扬州新瑞连、汇成投资、杨会构成一致行动人。 ②金燕系杨绍校兄弟的配偶。 除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

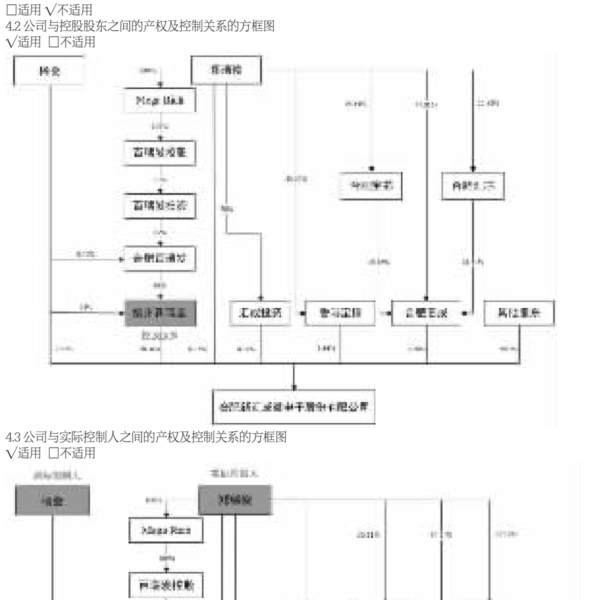
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

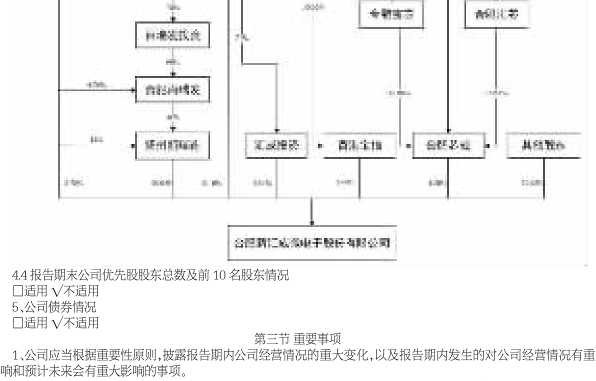
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入 178,313.55 万元,较上年同期增长 18.79%;实现归属于上市公司股东的净利润 15,473.06 万元,较上年同期减少 3.15%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,409.96 万元,较上年同期减少 7.39%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688403　　证券简称:汇成股份　　公告编号:2026-009
转债代码:118049　　转债简称:汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"汇成股份")董事会编制了 2025 年度(以下简称"报告期"或"本报告期")募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕883 号),本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券 11,487,000 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,共计募集资金 1,148,700,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 3,500,000.00 元(不含税)后的募集资金为 1,145,200,000.00 元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2024 年 8 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,672,108.48 元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 1,142,527,891.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2024〕336 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	114,252.79
截至期初累计发生额	项目投入	B1	105,958.26
	利息收入净额	B2	68.86
本期发生额	项目投入	C1	6,371.82
	利息收入净额	C2	40.65
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	112,330.08
	利息收入净额	D2=B2+C2	109.51
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,032.22
实际结余募集资金		F	2,032.22
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司(以下简称"江苏汇成")对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2024 年 8 月分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
广发银行股份有限公司扬州分行营业部	9550880246966300186		已销户
中信银行股份有限公司合肥瑶海支行	8112301013201026778	20,322,211.26	
招商银行股份有限公司合肥分行营业部	514902669010002		已销户
浙商银行股份有限公司合肥分行营业部	3610000010120100588108		已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100460563		已销户
中国银行股份有限公司扬州邗江支行	520980997944		已销户
招商银行股份有限公司扬州邗江支行	514902342810000		已销户
	合 计	20,322,211.26	

注:公司存放于广发银行股份有限公司扬州分行营业部、招商银行股份有限公司合肥分行营业部、浙商银行股份有限公司合肥分行营业部、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州邗江支行专户的募集资金已按规定用途全部使用完毕,并完成了上述募集资金专户的注销手续,公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行或其有签订募集资金监管协议权限的上级分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

上述存款余额中,已计入募集资金专户现金管理及利息收入 111.74 万元(其中 2025 年度现金管理及利息收入 41.91 万元),已扣除手续费 2.23 万元(其中 2025 年度手续费 1.27 万元),现金管理及利息收入累计净额 109.51 万元(其中 2025 年度现金管理及利息收入净额 40.65 万元)。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日,本公司的募集资金的实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

本报告期,公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品),并以协定存款方式存放募集资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2024-081)。

本期购买及赎回理财产品(含结构性存款)如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	购买金额	购买日	到期日	本年收益	是否赎回	期末余额
中信银行股份有限公司合肥瑶海支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 07330 期	5,000.00	2024/12/12	2025/1/11	8.84	是	0.00
合 计		5,000.00			8.84		0.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(七)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本报告期,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

本报告期,公司不存在节余募集资金使用情况。

(九)募集资金使用的其他情况

由于本次公开发行实际募集资金净额 114,252.79 万元少于《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟投入的募集资金金额 114,870.00 万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,根据可转债发行时对董事会的授权,结合公司实际情况,公司对募投项目使用募集资金金额进行调整,调整后的投资总额见附件 1。

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》,公司不特定对象发行可转换公司债券募投项目"12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目"的实施主体为全资子公司江苏汇成公司,公司拟使用募集资金 30,000.00 万元人民币向江苏汇成增资用于实施上述募投项目。此外,公司拟使用募集资金向江苏汇成提供 20,000.00 万元人民币借款。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-077)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司使用募集资金向江苏汇成公司累计提供借款 20,000.00 万元。

(十)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(十一)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力,降低公司流动性风险及营业风险,增强公司的经营能力,有利于公司扩大业务规模,优化财务结构,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为,汇成股份公司董事会编制的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》(上证发〔2025〕69 号)有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了汇成股份公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为,公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上,保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2026 年 3 月 20 日

附件 1:募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表
2025 年度

编制单位:合肥新汇成微电子股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				114,252.79	本年度投入募集资金总额						6,371.82	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						112,330.08	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	4,158.04	33,044.68	-1,955.32	94.41	2026 年 6 月	456.72	不适用	否
12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2,213.77	50,028.58	28.58	100.06	2026 年 6 月	1,100.35	不适用	否
补充流动资金	否	29,870.00	29,252.79	29,252.79		29,256.81	4.02	100.01		不适用	不适用	否
合 计	–	114,870.00	114,252.79	114,252.79	6,371.82	112,330.08	-1,922.71	–	–	1,557.07	–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三(二)之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况					详见本专项报告三(四)之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					详见本专项报告三(九)之说明							

注 1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3:"12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目"和"12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目"是以本公司及江苏汇成为实施主体,是本公司及江苏汇成利用现有厂区,在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后,本公司及江苏汇成 12 吋先进制程新型显示驱动芯片金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。

注 4:上表中合计值尾差系四舍五入导致。

证券代码:688403　　证券简称:汇成股份　　公告编号:2026-015
转债代码:118049　　转债简称:汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于补充确认对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州芯璞")系专业投资机构苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"兰璞创投")和合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"汇成股份")共同出资设立私募基金,主要投向为半导体相关产业链。在公司 2025 年度财务报表审计过程中,苏州芯璞被纳入公司合并报表范围。

● 2025 年 12 月,公司与苏州芯璞共同对合肥鑫丰科技有限公司(以下简称"鑫丰科技")增资人民币 6,000.00 万元,其中公司与苏州芯璞分别增资 3,000.00 万元,本次增资属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则")中规定的"对外投资"。本次增资前,公司于 2025 年 10 月份通过受让股权的方式直接取得鑫丰科技 18.4414%的股权,公司副总经理黄振芳先生于 2025 年 10 月底被公司委派担任鑫丰科技董事;公司董事洪伟刚先生自 2021 年 8 月至今担任鑫丰科技董事。因此,鑫丰科技属于公司关联法人,公司与苏州芯璞本次对鑫丰科技增资构成《上市规则》规定的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易的实施不存在重大法律障碍,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

● 2025 年 7 月,苏州芯璞与合肥万诺康电子有限公司(以下简称"万诺康")签订投资协议,苏州芯璞以可转债方式向万诺康提供投资款人民币 2,500.00 万元,苏州芯璞有权按照协议约定将前述投资款转为对万诺康的增资款。本次投资前,公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生之子郑瀚先生直接持有万诺康 23%的股权,并通过其持股 100%的香港瑞仕投资控股有限公司间接持有万诺康 18%的股权,是万诺康的主要股东。因此,万诺康属于公司关联法人,苏州芯璞以可转债形式投资万诺康构成《上市规则》规定的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易的实施不存在重大法律障碍,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

● 过去 12 个月内,除前述增资外,公司与鑫丰科技之间不存在其他关联交易情形;过去 12 个月内,除前述苏州芯璞可转债投资外,公司与万诺康之间不存在其他关联交易情形。

● 因交易发生时公司未能及时识别鑫丰科技为公司关联法人导致未及时履行关联交易审议和披露程序;此外,经年度财务报表审计机构确认,尽管公司系作为有限合伙人参与苏州芯璞投资设立,但因公司在苏州芯璞的认缴出资比例为 99.07%,应将苏州芯璞纳入合并范围。基于以上背景,公司对上述对外投资事项追加确认为关联交易并补充审议和披露。

● 2026 年 3 月 19 日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第二届董事会第十七次会议对上述关联交易事项进行补充审议。因公司与苏州芯璞对鑫丰科技增资之关联交易金额占公司最近一期经审计总资产 1%以上,且超过 3,000.00 万元,该事项尚需提交公司股东会批准;苏州芯璞以可转债形式投资万诺康之关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产 1%以上,且未超过 3,000.00 万元,该事项无需提交公司股东会批准。

一、补充确认对外投资暨关联交易概述

(一)公司与苏州芯璞增资鑫丰科技的基本情况

1、本次交易概况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开总经理办公会,审议通过以人民币 3,000 万元的价格认购鑫丰科技新增注册资本人民币 1,556.244451 万元,增资款中 1,556.244451 万元计入鑫丰科技注册资本,剩余部分计入鑫丰科技资本公积。鉴于公司于 2025 年 10 月通过受让股权的方式直接取得鑫丰科技 18.4414%的股权,本次增资完成后公司直接持有鑫丰科技股权的比例增至 20.9403%。本次增资时点,公司董事洪伟刚先生、副总经理黄振芳先生担任鑫丰科技董事,鑫丰科技属于公司关联法人,因公司未能及时识别鑫丰科技为公司关联法人导致未及时履行关联交易审议和披露程序。

经年度财务报表审计机构确认纳入公司合并范围内私募基金苏州芯璞亦同时参与本次增资,于 2025 年 12 月以人民币 3,000 万元的价格认购鑫丰科技新增注册资本人民币 1,556.244451 万元,增资款中人民币 1,556.244451 万元计入鑫丰科技注册资本,剩余部分计入鑫丰科技资本公积。本次增资完成后苏州芯璞直接持有鑫丰科技 3.9591%的股权。本次增资时点,公司未识别苏州芯璞属于公司合并报表范围内私募基金,苏州芯璞向鑫丰科技的增资决策由苏州芯璞投资决策委员会作出,苏州芯璞投资决策委员会成员为 3 名,均由兰璞创投委派,公司作为有限合伙人未直接参与投资决策,但因公司在苏州芯璞的认缴出资比例为 99.07%,应将苏州芯璞纳入合并范围。

根据《上市规则》等相关规定,公司与苏州芯璞对鑫丰科技共同增资事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易未达到重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

2、交易要素

交易事项	与合并报表范围内私募基金共同向关联法人增资
交易标的的名称	合肥鑫丰科技有限公司
是否涉及跨境交易	□是 √否
投资金额	公司与苏州芯璞各投资 3,000 万元,共计 6,000 万元
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:____________
支付安排	√ 全额一次付清,约定付款时点:增资协议约定交割日后 10 个工作日内 □ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

3、董事会审议此次交易相关议案的表决情况

2026 年 3 月 19 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》。关联董事洪伟刚先生对该议案回避表决。

4、交易尚需履行的审批及其他程序

本次增资暨关联交易金额共计 6,000.00 万元,占公司最近一期经审计总资产 1%以上,且超过 3,000.00 万元,该关联交易事项尚需提交公司股东会批准。

本次增资已于 2025 年 12 月 25 日完成工商变更登记手续,除追加股东会审议外不存在其他未履行的审批手续。

5、过去 12 个月内与鑫丰科技之间关联交易情况

截至本公告披露日,过去 12 个月内公司与关联法人鑫丰科技之间不存在其他关联交易。

(二)苏州芯璞可转债投资与万诺康的基本情况

1、本次交易概况

2025 年 7 月,苏州芯璞与万诺康签订投资协议,约定苏州芯璞以可转债方式向万诺康提供投资款人民币 2,500.00 万元,苏州芯璞有权按照协议约定将债权投资转为对万诺康的股权投资。

投资协议签署时点,公司未识别苏州芯璞属于公司合并报表范围内私募基金,苏州芯璞向鑫丰科技的增资决策由苏州芯璞投资决策委员会作出,苏州芯璞投资决策委员会成员为 3 名,均由兰璞创投委派,公司作为有限合伙人未直接参与投资决策,但因公司在苏州芯璞的认缴出资比例为 99.07%,应将苏州芯璞纳入合并范围。

鉴于公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生之子郑瀚先生直接持有万诺康 23%的股权,郑瀚先生持股 100%的香港瑞仕投资控股有限公司持有万诺康 18%的股权,是万诺康的主要股东,因此万诺康属于公司关联法人。根据《上市规则》等相关规定,苏州芯璞对万诺康可转债投资事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,此次交易未达到重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

2、交易要素

交易事项	苏州芯璞可转债投资万诺康
交易标的的名称	合肥万诺康电子有限公司
是否涉及跨境交易	□是 √否
投资金额	以可转债方式提供投资款人民币 2,500.00 万元,苏州芯璞有权按照协议约定将债权投资转为对万诺康的股权投资
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:____________
支付安排	√ 全额一次付清,约定付款时点:协议签订之日起 10 日内 □ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

3、董事会审议此次交易相关议案的表决情况

2026 年 3 月 19 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补充确认苏州芯璞向万诺康可转债投资暨关联交易的议案》。关联董事郑瑞俊先生对该议案回避表决。

4、交易尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易金额共计 2,500.00 万元,未达到公司最近一期经审计总资产 1%以上,且未超过 3,000.00 万元,该关联交易事项无需提交公司股东会批准。

5、过去 12 个月内与万诺康之间关联交易情况

截至本公告披露日,过去 12 个月内公司与关联法人万诺康之间不存在其他关联交易,并且苏州芯璞已依据协议相关约定收回对万诺康的全部投资。

二、关联法人暨关联交易标的基本情况

(一)鑫丰科技

合肥鑫丰科技有限公司成立于 2019 年 11 月 25 日,主营业务为 DRAM 存储芯片封装测试。公司于 2025 年 10 月以人民币 9,048.41 万元的价格受让华东科技(苏州)有限公司持有的鑫丰科技 6,675.00 万元出资额对应股权,自此公司成为鑫丰科技股东。前述股权转让完成后,公司直接持有鑫丰科技 18.4414%的股权,公司于 2025 年 10 月底委派副总经理黄振芳先生担任鑫丰科技董事。

1、基本信息

法人 / 组织名称	合肥鑫丰科技有限公司
统一社会信用代码	91340111MA2UBB2C9Q
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
交易方式	□向交易对方支付现金 √向标的公司增资 □其他:___
成立日期	2019年 11 月 25 日
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区空港经济示范区硕放路一号 A101 厂房
主要办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区空港经济示范区硕放路一号 A101 厂房
法定代表人	许丰
注册资本	人民币 39,308.141102 万元
经营范围	集成电路设备贸易及产品制造,并提供售后服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	DRAM存储芯片封装测试
所属行业	根据《国民经济行业分类》(GB/4754-2017),公司属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"之"C3973 集成电路制造业"
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他:由公司董事、高级管理人员担任董事的企业

2、主要财务数据

单位:万元

标的资产名称	合肥鑫丰科技有限公司	
是否经过审计	□是 √否	
项目	2024年度 / 2024 年 12 月 31 日	2025年度 / 2025 年 12 月 31 日
资产总额	40,486.57	46,320.46
负债总额	39,260.40	32,731.57
净资产	1,226.17	13,588.89
营业收入	16,379.69	17,802.44
净利润	-8,635.61	-9,137.29
扣除非经常性损益后的净利润	-9,611.86	-9,640.11

3、增资前后股权结构

单位:人民币万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资金额	占比(%)	认缴出资金额	占比(%)
1	苏州工业园区晶汇聚鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	8,980.443451	24.8108	8,980.443451	22.8463
2	华东科技(苏州)有限公司	8,325.000006	23.0000	8,325.000006	21.1788
3	汇成股份	6,674.999994	18.4414	8,231.244445	20.9403
4	合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业(有限合伙)	2,595.895623	7.1718	2,595.895623	6.6040
5	苏州启鸿创业投资合伙企业(有限合伙)	2,595.895623	7.1718	2,595.895623	6.6040
6	合肥经开产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,561.215002	7.0760	2,561.215002	6.5157
7	合肥森祺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,500.000000	6.9069	2,500.000000	6.3600
8	深圳中天精艺投资有限公司	1,962.202501	5.4211	1,962.202501	4.9918
9	苏州芯璞	–	–	1,556.244451	3.9591
合计		36,195.652200	100.00	39,308.141102	100.00

4、出资方式及相关情况

此次出资方式为货币出资,资金来源为自有资金,不涉及汇成股份募集资金。

5、权属情况

鑫丰科技股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

6、本次关联交易的定价情况

本次关联交易仅涉及公司及公司合并报表范围内私募基金对关联法人鑫丰科技进行增资,鑫丰科技其他股东未参与增资。增资方式为货币出资,增资价格为 1.9277 元 / 注册资本,系增资方与鑫丰科技及其原股东参考鑫丰科技前轮股权转让价格协商确定,未对本次增资进行审计或资产评估。本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

7、增资协议的主要内容

1)本次增资

汇成股份和苏州芯璞同意按照协议约定分别以人民币 3,000 万元为对价,认购鑫丰科技新增注册资本人民币 1,556.244451 万元。增资款中人民币 1,556.244451 万元计入鑫丰科技注册资本,剩余部分计入鑫丰科技资本公积。

2)股权比例

除汇成股份和苏州芯璞外,本轮无其他现有股东参与增资,本次增资完成后汇成股份直接持有鑫丰科技 20.9403%的股权,苏州芯璞直接持有鑫丰科技 3.9591%的股权。

3)增资款的缴付

自增资协议所述的交割前提条件满足或经本轮投资人以书面形式予以豁免后十个工作日之内,汇成股份、苏州芯璞应当将全部本轮增资款汇入由鑫丰科技事先书面指定的银行账户。

4)交割前提条件

本轮投资人按照协议的规定向鑫丰科技支付增资款应当以交割前提条件全部满足或被本轮投资人自行决定事先书面豁免为交割前提条件。

5)违约责任

如任何一方违反了其在增资协议项下的任何保证、承诺、约定或其他任何规定,或任何一方在协议项下做出的任何陈述为不真实的陈述,从而致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,则违约方或做出不实陈述的一方应就上述全部可偿损失赔偿其他方。

8、关联关系说明

鉴于公司董事洪伟刚、副总经理黄振芳担任鑫丰科技董事,鑫丰科技属于公司关联法人,根据《上市规则》等相关规定,公司与苏州芯璞本次向鑫丰科技增资事项构成关联交易。

(二)万诺康

合肥万诺康电子有限公司成立于 2023 年 10 月 17 日,注册资本 6,000.00 万元。万诺康是一家注册于合肥新站高新区的半导体产业链企业,其主营业务为显示模组及整体解决方案。

1、基本信息

法人 / 组织名称	合肥万诺康电子有限公司
统一社会信用代码	91340100MAD3LXB75A
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
交易方式	□向交易对方支付现金 □向标的公司增资 √其他:以可转债形式向万诺康投资
成立日期	2023年 10 月 17 日
注册地址	合肥市新站区魏武路与大禹路交口蓝科新站芯屏高科技产业园 C1 栋
主要办公地址	合肥市新站区魏武路与大禹路交口蓝科新站芯屏高科技产业园 C1 栋
法定代表人	谢文智
注册资本	6,000.00 万人民币
经营范围	一般项目:显示器件销售;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;显示器件制造;可穿戴智能设备制造;智能家庭消费设备制造;智能车载设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子专用材料制造;其他电子器件制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主营业务	显示模组及整体解决方案
所属行业	根据《国民经济行业分类》(GB/4754-2017),万诺康属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"之"C3974 显示器件制造"
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他:实控人关系密切的家庭成员为主要股东的企业

2、主要财务数据

单位:万元

标的资产名称	合肥万诺康电子有限公司	
是否经过审计	□是 √否	
项目	2024年度 / 2024 年 12 月 31 日	2025年度 / 2025 年 12 月 31 日
资产总额	13,025.72	10,705.36
负债总额	10,687.14	7,425.70
净资产	2,338.58	3,279.66
营业收入	5,471.26	4,000.28
净利润	-925.72	-1,474.92
扣除非经常性损益后的净利润	-950.41	-1,219.88

3、万诺康股权结构

单位:人民币万元

序号	股东名称	认缴出资金额	占比(%)
1	谢文智	2,640.00	44.00
2	郑瀚	1,380.00	23.00
3	香港瑞仕投资控股有限公司	1,080.00	18.00
4	长晶贸易有限公司	600.00	10.00
5	ADVANCE ALLIED LIMITED	300.00	5.00
合计		6,000.00	100.00

注 1:长晶贸易有限公司系谢文智实际控制的公司,谢文智系万诺康实际控制人。

注 2:香港瑞仕投资控股有限公司系郑瀚持股 100%的公司。

4、出资方式及相关情况

此次出资方式为货币出资,资金来源为自有资金,不涉及汇成股份募集资金。

5、权属情况

万诺康股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

6、本次关联交易的定价情况

本次关联交易为苏州芯璞以可转债方式向万诺康提供投资款人民币 2,500.00 万元,苏州芯璞有权按照协议约定将债权投资转为对万诺康的股权投资。交易定价系经苏州芯璞与万诺康在平等互利的原则基础上协商确定。

7、投资协议的主要内容

1)整体方案及投资目的

苏州芯璞以可转债方式向万诺康提供投资款人民币 2,500.00 万元,苏州芯璞有权按照协议相关约定将前述投资款转为对万诺康的增资。

2)投资款的支付

自协议签订之日起 10 日内,苏州芯璞应将前述投资款足额支付至万诺康指定的专用账户。

3)转股安排

①投资期为自协议项下投资款全部到达万诺康账户之日起 18 个月。

②苏州芯璞有权在投资期内随时将协议项下投资款的全部或部分转为苏州芯璞对万诺康的增资款,且苏州芯璞无需满足任何附加条件。

③协议各方一致确认并同意,苏州芯璞根据协议约定实施转股时,增资价格不超过人民币 10 元 / 注册资本,具体以各方另行签署的投资框架协议或增资协议约定为准。

④转股完成日前,在取得了应取得的同意且履行了应履行的程序的基础上若万诺康按照应履行的程序以低于转股价格进行新的股权融资(包括但不限于增资扩股、以可转债券或其他可转换为股权的证券票据进行融资等),则转股价格自动变更为新的股权融资价格。

⑤转股完成日前,在取得了应取得的同意且履行了应履行的程序的基础上,若万诺康按照应履行的程序进行分红,则增资金额应相应增加按照转股后股权比例对应的分红金额,根据转股价格重新确定最终转股的注册资本数。

4)未转股的安排

①如投资期届满时,未发生协议约定的转股事项,万诺康应于投资期届满之日起 30 日内向苏州芯璞归还届时未转股部分的投资款本金,并支付以年利率单利 6%计算的利息,利随本清。

②经苏州芯璞书面同意,投资期内,若发生重大不利影响、投资协议被终止或解除、清算事件、控制权变更事件及回购事件,苏州芯璞有权通过书面方式,要求还款义务人偿还相应本金及利息。

8、关联关系说明

鉴于公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生之子郑瀚先生直接持有万诺康 23%的股权,郑瀚先生持股 100%的香港瑞仕投资控股有限公司持有万诺康 18%的股权,是万诺康的主要股东,因此万诺康属于公司关联法人。根据《上市规则》等相关规定,苏州芯璞对万诺康可转债投资事项构成关联交易。

三、关联交易的必要性、合理性以及对公司的影响

(一)关联交易的必要性

1、公司与苏州芯璞增资鑫丰科技

鑫丰科技凭借其原母公司中国台湾上市公司华东科技股份有限公司在 DRAM 封测领域深厚的技术工艺积累,基于其掌握的 PoP 堆叠封装工艺,是境内最早为长鑫存储提供 LPDDR 封装配套的封测厂商之一,亦是长鑫存储供应体系中少数具备 LPDDR5 量产封装能力的重要合作伙伴,目前具备超 2 万片 / 月 Wafer 封装产能,在 DRAM 封测领域具备较好的业务基础和技术先进性。公司与苏州芯璞此次增资完成后,有助于为公司联营企业鑫丰科技增厚资本、扩充产能,从而带来较好的预期财务回报,本次关联交易对于公司来说具有商业必要性。

2、苏州芯璞可转债投资万诺康

万诺康主营业务以手机售后市场显示模组为主,主要为高端手机产品提供优质的显示解决方案;同时,万诺康管理团队在存储分销市场积累了深厚产业资源,伴随人工智能对存储业务需求的快速增长,万诺康正积极布局境内外存储分销市场,为客户提供定制化的存储模组产品。苏州芯璞此次投资万诺康基于看好万诺康在显示模组和存储模组分销市场的未来发展和财务回报,以风险可控的可转债方式进行产业投资,本次关联交易对于苏州芯璞所从事的产业投资来说具有商业必要性。

(二)关联交易定价的合理性

1、公司与苏州芯璞增资鑫丰科技

(下转 74 版)